

证券代码： 600601

证券简称： 方正科技

方正科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-0601

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年6月19日-6月27日
地点（方式）	线上、线下交流
参与单位（或人员）	财通证券、中金公司、永赢基金、银华基金、平安资管、建信基金、国泰基金、鹏华基金、天弘基金、财通资管、南方基金、博时基金、摩根华鑫基金、国金证券、华西证券、广发基金、易方达基金、富国基金
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：陈宏良 董事会秘书：梁加庆 证券事务代表：戴继东
投资者关系活动主要内容介绍	调研会议互动问答的主要内容如下： 问：公司 PCB 业务的情况介绍？ 答：公司 PCB 业务核心主体为珠海方正科技多层电路板有限公司，经过 30 余年的业务发展，在高多层和高密度互联（HDI）领域

具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。专业服务全球中高端客户，2023 年公司 PCB 业务实现营业收入 30.22 亿元，净利润 1.78 亿元。

问：能否进一步说明服务存储业务的情况？对于 AI 服务器，公司有何布局和进展情况？

答：公司内部将服务存储分为两类，一是传统的服务器；二是基于云计算的应用环境下的 AI 服务器。公司已具备 AI 服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶 HDI 的制作能力，为未来的市场需求做好准备。

问：公司在交换机领域的布局情况如何？是否已经开始实现批量生产？

答：交换机领域公司已具备 400G 和 800G 的技术和批量生产能力。

问：今年公司业务增量最大的部分是什么？光模块业务今年发展状况如何？

答：2024 年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产 10G-100G-200G-400G-800G 等光模块产品，同时，1.6T 连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。

问：公司产能扩产投资情况？

答：公司现有在运营的工厂共 4 间，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平。国内 F3 工厂的技改、MSAP 产线、F7 二期 HDI 的投资均已完成，高端 HDI 产能占比正在稳步提升。海外投资约 9.43 亿元建设方正科技（泰国）智造基地项目，通过保质量、抢

工期、控成本，各项工作正在按计划有序推进。

问：公司 HDI 产能情况如何？与同行业的竞争对手相比，公司在高端高阶 HDI 领域的竞争力如何？

答：目前，公司的 HDI 规划产能合计为 46.5 万平方英尺/月，其中 F3 工厂的规划产能为 35 万平方英尺/月，F7 二期 HDI 的规划产能为 11.5 万平方英尺/月。在 HDI 领域，公司处于国内行业前列，具有一定的行业竞争力。

问：公司今年上半年工厂稼动率大致处于什么水平？

答：今年公司 PCB 工厂的稼动率较去年同期有所提升。

问：公司在境外的业务布局？

答：境外业务主要是公司 PCB 产品的出口，地区包括北美、欧洲、日本、韩国及其他亚洲国家或地区，境外业务约占公司整体营收的三分之一。

公司正在积极开拓境外市场，有序推进投资建设方正科技（泰国）智造基地项目，以满足境外订单需求。

问：公司的短期经营情况如何？二季度与全年业绩展望如何？

答：2024 年上半年，PCB 市场行情普遍好于去年同期，公司的经营情况正在平稳提升。具体讲，一是通过技术能力提升和自建产能，公司高端产能得到进一步扩充，高阶 HDI 占比稳步提升；二是通过 UHD、FVS、Cavity 等关键技术突破，为客户提供更好的产品解决方案，助力市场开拓；三是积极布局高增长领域，持续优化客户群和产品订单结构。公司的经营数据还请关注公司在上海证券交易所发布的公告。

问：公司其他非 PCB 业务如何处理，后续是否考虑并购？

答：公司目前还有少量的历史遗留业务——融合通信，正在积

	<p>极探索盘活方式，未来公司将进一步聚焦 PCB 主业，并结合经营战略需要，寻找与公司 PCB 业务在市场、品类、技术等能够资源互补的标的，探求战略并购。</p> <p>问：公司的资金情况如何，对于今后的扩张计划公司的融资策略是什么？</p> <p>答：目前公司资产负债率较低，主要依靠自有资金和银行借款融资。公司将根据公司战略发展规划、外部经营环境、实际投资需求以及相关政策的变化制定公司中长期投融资规划。</p> <p>问：公司是否有员工激励方面的安排？</p> <p>答：公司将按照相关规定并结合公司实际经营情况予以综合考量。</p> <p>问：铜材料成本上升对公司是否有影响？</p> <p>答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐等，原物料供应的稳定性和价格走势影响公司生产的稳定性和盈利能力。近期受铜等大宗商品价格变化影响，部分材料价格有所上升，目前对公司经营影响可控。PCB 产品价格传导受产品结构和供需结构的影响，公司会积极与供应链和客户保持沟通，保证公司的良性经营。</p>
附件（如有）	无
记录时间	2024 年 6 月 28 日整理